### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-094152

(43) Date of publication of application: 06.04.2001

(51)Int.CI.

H01L 33/00

(21) Application number: 11-263325

(71)Applicant: KORAI KAGI KOFUN YUGENKOSHI

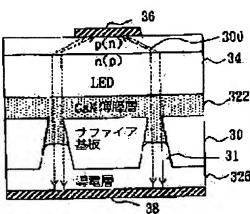
(22) Date of filing: 17.09.1999 (72)Inventor: SO HOJO

### (54) UPRIGHT LED AND STRUCTURE OF CURRENT FLOW CIRCUIT THEREOF

#### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an upright LED and the structure of its current flow circuit, wherein a current flow circuit for current flow is effectively demarcated and the current density as well as light-emission efficiency in the effective region are increased, while a dicing process is simplified and a product yield is improved.

SOLUTION: Related to a sapphire substrate of a blue light LED with a sapphire as a substrate, at least one channel is provided by symmetrical etching with a first electrode as a center. One GaN thin-film layer of about the same thickness is formed above and below the substrate, and the upper and lower GaNs are brought into contact to the channel to naturally form a current flow circuit for the LED. The current flow circuit leads to a conductive layer through each one channel in a buffer thin-film layer, an epitaxial layer, and the substrate from the first electrode, forming an upright LED with the sapphire as a substrate.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

25.06.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

08.07.2003

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-94152 (P2001-94152A)

(43)公開日 平成13年4月6日(2001.4.6)

(51) Int.Cl.7

識別配号

FΙ

テーマコード(参考)

H01L 33/00

H01L 33/00

E 5F041

С

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平11-263325

(22)出願日

平成11年9月17日(1999.9.17)

(71)出願人 599012237

光磊科技股▲ふん▼有限公司

台湾、新竹科学工業園区創新一路8号

(72)発明者 莊 豊如

台湾新竹市竹光路78巷11弄23號

(74)代理人 100082304

弁理士 竹本 松司 (外5名)

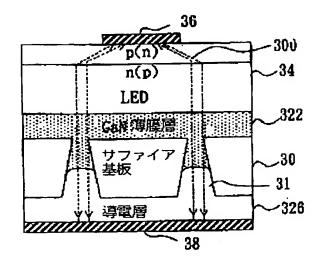
Fターム(参考) 5F041 CA40 CA46 CA77 CA93 CA99

# (54) 【発明の名称】 直立式LEDとその電流流動回路の構造

### (57)【要約】

【課題】 有効に電流流動の電流流動回路を画定し、その有効領域の電流密度と発光効率を増加できる直立式LEDとその電流流動回路の構造の提供。シング工程を簡易化でき、製品の歩留りを向上できる、LEDの基板構造。

【解決手段】 サファイアを基板とする青色光LEDのサファイア基板中にあって、第1電極を中心として対称方式のエッチングで少なくとも一つのチャネルを設け、並びに基板の上下にそれぞれ厚さが近似の一つのGaN薄膜層を形成し、且つ上下のGaNを中空の上記チャネル内に接触させて該LEDの電流流動回路を自然に形成させ、該電流流動回路を、第1電極よりバッファ薄膜層、エピタキシャル層、基板内の各一つのチャネルを通して導電層に至るものとし、こうしてサファイアを基板とする直立式LEDを形成した。



# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板とされ、該基板の適宜位置にエッチ ングにより該基板を貫通する少なくとも一つのチャネル が形成され、との中空のチャネル内に少なくとも一種類 の導電材料が存在する、上記基板、

該基板の上に形成されたバッファ薄膜層、

pn接合を有するLEDエピタキシャル層とされ、該バ ッファ薄膜層の上に成長させられ、且つ該LEDエピタ キシャル層の一部の表面上に第1電極が形成された、上 記LEDエピタキシャル層、

該基板の下に形成された導電層とされ、上記第1電極か ら上記バッファ薄膜層、LEDエピタキシャル層、基板 内の各一つのチャネルを通り、該導電層に至るLEDの 電流流動回路を自然に形成させる、上記導電層、

以上を具備したことを特徴とする、直立式LED。

【請求項2】 前記第1電極を中心としてその周囲に対 称方式を以て少なくとも一つのチャネルが形成されたと とを特徴とする、請求項1に記載の直立式LED。

【請求項3】 前記基板のチャネル内の導電材料が、前 記バッファ薄膜層及び前記導電層と同じ材料とされて該 20 チャネル内で接触するように設けられていることを特徴 とする、請求項1に記載の直立式LED。

【請求項4】 前記基板がサファイア基板とされたこと を特徴とする、請求項1に記載の直立式LED。

【請求項5】 前記バッファ薄膜層がGaNで組成され たGaN薄膜層とされたことを特徴とする、請求項4に 記載の直立式LED。

【請求項6】 前記導電層が非金属導電材料で組成され たことを特徴とする、請求項1に記載の直立式LED。 【請求項7】 前記導電層がGaNで組成されたGaN 30 薄膜層とされたことを特徴とする、請求項5に記載の直 立式LED。

【請求項8】 前記直立式LEDにおいて、上下のGa N薄膜層が同じ厚さとされたことを特徴とする、請求項 7に記載の直立式LED。

【請求項9】 前記バッファ薄膜層と導電層の厚さが近 似とされたことを特徴とする、請求項1に記載の直立式 LED.

【請求項10】 前記第1電極が透明材料で形成された ことを特徴とする、請求項1 に記載の直立式LED。

【請求項11】 前記導電層の基板と連接しない部分の 表面に第2電極が設けられ、その電流流通回路が第1電 極からバッファ薄膜層、LEDエピタキシャル層、基板 の各一つのチャネル、導電層を通り該第2電極に至ると とを特徴とする、請求項1に記載の直立式LED。

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一種の直立式LE Dとその電流流動回路の構造に係り、特に、サファイア にあって、第1電極を中心として対称方式のエッチング により少なくとも一つのチャネルを形成し、並びに中空 のチャネル内に一つの導電材料を存在させて、LEDの 電流流動回路を自然に形成させて有効に区画及び応用さ れるようにした、直立式LEDとその電流流動回路の構 造に関する。

[0002]

【従来の技術】LEDは50年代より発展して現在に至 っており、寿命が長く、体積が小さく、発熱量が少な く、消耗電力が少なく、反応速度が速く、及び単性光発 光の特性とメリットから、わずか数十年間の間に各種の. 生活用品及び機器設備、例えばコンピュータ周辺設備、 時計のディスレイ、広告看板、交通標識灯、通信業、或 いは消費型電子製品中に大量に使用されるようになって おり、この製品の応用範囲の広さには驚かざるをえな い。特に青色光LEDが発売された後、赤色光、緑色光 が前後して生産され、ゆえにこれらを組み合わせたフル カラーの完全基本構造が、色彩上の変化性において利用 されたり、伝統的な白熱照明光源の代わりとして応用さ れている。

【0003】現在、青色光LEDの製造には、サファイ ア基板を使用するものと炭化シリコン (SiC)基板を 使用するものとに大きく分けられる。図1は、周知の炭 化シリコンを基板とする直立式LEDの構造断面図であ る。そのうち、炭化シリコン基板10の上に、アルミニ ウム、ガリウム、リン、窒素等の三五族をドープしたバ ッファ薄膜層12が形成され、さらにこのバッファ薄膜 層の上にスパッタ或いは蒸着によりpn接合を有して青 色光を発射可能なLEDエピタキシャル層14が形成さ れている。炭化シリコン基板10は導電体であるため、 LEDエピタキシャル層14と炭化シリコン基板10の 一部の表面上に個別に第1電極(陽極)16と第2電極 (陰極)18がめっき形成され、とうして一つの直立式 LEDが形成されている。その電流流動回路は点線10 0で示されている。

【0004】上述の実施例中、第1電極16の多くは不 透明材料で製造され、とのため第1電極16の下に位置 する電流回路の発射する発射光は第1電極16に吸収さ れるか阻止され、輝度を高めるのに役立たない。とのた 40 め、LEDのクラッド層の上にさらに一回以上のMOV PE工程により別に一つの電流阻止層145を設けて有 効発光領域の電流密度と発光効率を増加している(図2 参照)。この技術は、例えばアメリカ合衆国パテントN 0.5,153,889或いは台湾パテント公告第26 4573号中に示されている。

【0005】炭化シリコンを基板とするLEDは直立式 青色光LEDに設計して、光電製品の軽薄短小の設計目 標に符合させることができるとはいえ、炭化シリコン基 板のLEDの輝度、コントラスト等の物性、或いは導電 を基板とする青色光LEDにおいて、サファイア基板中 50 率等の電性はいずれもサファイア基板のLEDにはるか

に劣るため、将来的な発展性及び高輝度のLEDにはサ ファイア基板を用いるのが主流となっている。

【0006】図3は周知のサファイア基板のLEDの基 板構造の断面構造を示す。サファイア基板20の上には GaN薄膜層22が形成され、さらにGaN薄膜層22 の上にスパッタ或いは蒸着によりpn接合を有して青色 光を発射可能なLEDエピタキシャル層24が形成され ている。サファイア基板20は絶縁体であるため、LE Dエピタキシャル層24の上には同平面の第1電極26 (陽極)及び第2電極28 (陰極)のみ選択形成可能 で、平面式LEDのみが形成可能とされ、その電流流動 回路は点線200で示されるようである。その後、ダイ アモンド或いはレーザーを使用してダイシングが進行さ れて実際に必要な寸法のチップが得られる。

【0007】周知のサファイア基板のLEDには以下の ような欠点があった。

- (1)サファイア基板20自体は絶縁体とされ、導電特 性を有していないため、LEDの第1、第2電極26、 28を同一平面にめっきして形成しなければならず、作 用面積が大きくLED体積を縮小できないため、有効に 20 製品の軽薄短小の設計目標を達成できなかった。
- (2) サファイア基板20自体が絶縁体とされるため、 製造時に静電作用を引起しやすく、相対的に製品生産時 の不良率が高まった。
- (3) サファイア基板の上のGaN薄膜層 12 (厚さH 11) がアニーリング降温時にその基板に作用する応力の 不均一を引起しやすく、このためサファイア基板に亀裂 を生じさせ、工程上の面倒が増し、ゆえにその基板の厚 さH1を280 umより小さくすることができなかっ

【0008】一般に量産する時、基板厚さH1はいずれ も300 umより大きいものとされ、H11は即ち3~ 4 u m とされ、ゆえにそのH 1 と H 1 1 の厚さ比が約 1 00:1とされる。このような厚さのサファイア基板 は、後続のダイヤモンドカッタ或いはレーザーによるダ イシングの過程で非常に大きな困難につきあたる。即 ち、後続のレーザー或いはダイヤモンドを利用したダイ シングを行いやすいように、LED製造完成後に、さら にダイヤモンド等の高硬質材料でサファイア基板を約2 00 u m以上研磨する必要があり、このため工程上の手 間が増え、また、その電流流動回路を有効に区画できな いため、その発射光の輝度が第1電極の影響を非常に大 きく受け、輝度領域を有効に配置することができなかっ た。

【0009】とのため、サファイア基板LEDを直立式 の態様とし、その平面作用面積と製品体積を縮小した構 造であって、適度にその電流流動回路を画定して有効発 光領域の電流密度と発光効率を増し、且つダイシングが 正確に容易に行えるようにする新たな構造が求められて いた。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明の主要な目的 は、一種の直立式LEDとその電流流動回路の構造を提 供することにあり、それは、その硬度が非常に高いサフ ァイア基板を貫通するチャネルを具え、電流がこのチャ ネルを通過可能で、ゆえに適宜に電流流動回路が画定さ れ、発光有効領域の電流密度と発光効率が増加されるる ことを特徴とするものとする。

【0011】本発明の別の目的は、一種の直立式LED 10 とその電流流動回路の構造を提供することにあり、それ は煩雑なMOVPE工程により電流阻止層を形成しなく とも有効にその電流流動を有効発光領域において画定で きる特徴とするものとする。

【0012】本発明のさらに別の目的は、一種の直立式 LEDとその電流流動回路の構造を提供することにあ り、それはサファイア基板に少なくとも一つのチャネル が開設され、上下2層のプラスとマイナスの電極間の電 流通過の通路を提供し、ゆえに直立式光電ダイオードチ ップを形成可能で、これによりその作用面積を縮小しそ の構造の基板研磨の工程を簡素化できるものとする。

【0013】本発明のさらにまた別の目的は、一種の直 立式LEDとその電流流動回路の構造を提供することに あり、それは、サファイアの上下層それぞれに厚さが同 じGaN薄膜層が形成され、そのアニーリング冷却時に 形成される応力が相殺されて、とれにより必要な基板厚 さが大幅に減少可能とされて150 u m以下とされ、サ ファイヤ基板の亀裂を防止できると共に基板材料の資源 使用を節約でき、また後続の基板研磨の工程ステップを 簡易化できるものとする。

[0014]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、基板 とされ、該基板の適宜位置にエッチングにより該基板を 貫通する少なくとも一つのチャネルが形成され、この中 空のチャネル内に少なくとも一種類の導電材料が存在す る、上記基板、該基板の上に形成されたバッファ薄膜 層、pn接合を有するLEDエピタキシャル層とされ、 該バッファ薄膜層の上に成長させられ、且つ該LEDエ ピタキシャル層の一部の表面上に第1電極が形成され た、上記LEDエピタキシャル層、該基板の下に形成さ れた導電層とされ、上記第1電極から上記バッファ薄膜 層、LEDエピタキシャル層、基板内の各一つのチャネ ルを通り、該導電層に至るLEDの電流流動回路を自然 に形成させる、上記導電層、以上を具備したことを特徴 とする、直立式LEDとしている。請求項2の発明は、 前記第1電極を中心としてその周囲に対称方式を以て少 なくとも一つのチャネルが形成されたことを特徴とす る、請求項1に記載の直立式LEDとしている。請求項 3の発明は、前記基板のチャネル内の導電材料が、前記 パッファ薄膜層及び前記導電層と同じ材料とされて該チ 50 ャネル内で接触するように設けられていることを特徴と

6

する、請求項1に記載の直立式LEDとしている。請求 項4の発明は、前記基板がサファイア基板とされたこと を特徴とする、請求項1に記載の直立式LEDとしてい る。請求項5の発明は、前記バッファ薄膜層がGaNで 組成されたGaN薄膜層とされたことを特徴とする、請 求項4に記載の直立式LEDとしている。請求項6の発 明は、前記導電層が非金属導電材料で組成されたことを 特徴とする、請求項1に記載の直立式LEDとしてい る。請求項7の発明は、前記導電層がGaNで組成され たGaN薄膜層とされたことを特徴とする、請求項5に 10 記載の直立式LEDとしている。請求項8の発明は、前 記直立式LEDにおいて、上下のGaN薄膜層が同じ厚 さとされたことを特徴とする、請求項7に記載の直立式 LEDとしている。請求項9の発明は、前記バッファ薄 膜層と導電層の厚さが近似とされたことを特徴とする。 請求項1に記載の直立式LEDとしている。請求項10 の発明は、前記第1電極が透明材料で形成されたことを 特徴とする、請求項1に記載の直立式LEDとしてい る。請求項11の発明は、前記導電層の基板と連接しな い部分の表面に第2電極が設けられ、その電流流通回路 20 が第1電極からバッファ薄膜層、LEDエピタキシャル 層、基板の各一つのチャネル、導電層を通り該第2電極 に至ることを特徴とする、請求項1に記載の直立式LE Dとしている。

### [0015]

【発明の実施の形態】本発明は一種の直立式LEDとその電流流動回路の構造を提供しており、それは、サファイアを基板とする青色光LEDのサファイア基板中にあって、第1電極を中心として対称方式のエッチングで少なくとも一つのチャネルを設け、並びに基板の上下にそれでれ厚さが近似の一つのGaN薄膜層を形成し、且つ上下のGaNを中空の上記チャネル内に接触させて該LEDの電流流動回路を自然に形成させ、第1電極よりバッファ薄膜層、エピタキシャル層、基板内の各一つのチャネルを透過せしめて導電層に至らせ、こうしてサファイアを基板とする直立式LEDを形成し、且つその電流流動回路のチャネルの有効な案内により発射光の第1電極による吸収或いは阻止を減少し、相対的に有効発光領域の電流密度と発光効率を増加可能としたことを特徴としている。

### [0016]

【実施例】図4から図8、図9から図11は、それぞれ本発明の青色光LEDの望ましい実施例の各製造ステップにおける断面構造及び平面構造を示している。本発明は以下のステップを包括する:

ステップ1: 厚さが100 u m以下のサファイア基板30を選択し、並びにケミカルエッチング或いはマスクエッチングにより少なくとも一つの、サファイア基板30を貫通し且つ傾斜或いは直線態様のチャネル31を形成する(図4参照)。サファイア基板30を貫通するチ

ャネル31の配列方式は、第1電極(後述する)を中心 としてその周囲に対称方式で対応するチャネル31を形 成するものとする(図9参照)。

ステップ2: サファイア基板30の上にMOVPE法等のエピタキシャル方式を以て一層のバッファ薄膜層322、例えばGaN薄膜層を形成し、該GaN薄膜層の一部材料をチャネル31の空間中に存在させる(図5、図10参照)。

ステップ3: サファイア基板の下にエピタキシャル法 或いはスパッタ法により一層の導電層326を形成する、それは非金属導電材料で製造される。且つ導電層3 26の材料もまたチャネル31の一部空間に存在させる。これは図6及び図11に示されるとおりである。 ステップ4: GaN薄膜層322の上層にスパッタ或いは蒸着によりpn接合を有して青色光を発射可能なLEDエピタキシャル層34を形成し、これは当然、括弧内に示されるようにnp接合とすることが可能である。 これは図7に示されるとおりである。

ステップ5: LEDエピタキシャル層34の上及び導電層326の下に、相互に対応する第1電極36と第2電極38を形成する。こうして直立式のLEDチップが形成される。その電流流動回路300は第1電極36よりGaN薄膜層322、LEDエピタキシャル層34、基板内の各一つのチャネル31、導電層326を通り、第2電極38に至り、こうして完全な電流流動回路が形成される。これは図8に示されるとおりである。

【0017】さらに図8、図11及び図12に示される のは本発明のLEDチップの完成時の断面図、平面図及 び斜視図である。これらの図より明らかであるように、 本発明は第1電極36を中心点として、その周囲の基板 中にエッチングにより、サファイア基板30を貫通する 複数のチャネル31が設けられ、ゆえにその電流流動回 路300はチャネル31の位置により有効に画定されて 流動する。当然、電流が拡散して第1電極36の底の位 置に至る形態も選択可能であり、その他の有効発光領域 中にあってその電流密度を増加する。このような機能は 電流阻止層を利用する必要なく達成される。このほか、 全体設計のチャネル31の位置は、ウエハーをダイシン グして単一チップとなす時の助けとなり、これはそのチ 40 ャネル31位置を以て整然とした切断線を形成できると とと、チャネル部分がサファイア基板に対して容易に切 断できることが主要な原因である。

【0018】また、チャネル31内に充填される導電材料は導電目的に用いられ、ゆえに、上述の望ましい実施例において、上下2層のGaN材料と非金属導電材料はチャネル内において接触するが、ただし、単にチャネル内に導電材料が存在し且つ該導電材料がGaN薄膜層322と導電層326が接触する形態も可能である。

○を貸通し且つ傾斜或いは直線態様のチャネル31を形 [0019]最後に、図13に示されるのは本発明のも成する(図4参照)。サファイア基板30を貫通するチ 50 う一つの実施例である。この実施例には図3に示される

特開2001-94152

周知の技術が結合されている。との実施例に示されるように、導電層326の非金属導電材料はGaN薄膜層322と同じ材料を選択可能で、且つその上下2層の厚さH3、H4は相似或いは完全に同じとされうる。これにより、上下のGaN薄膜層322、324のアニーリング冷却時に発生する応力が相殺されてサファイア基板30の破壊が防止され、大幅にサファイア基板の使用厚さを減少でき、物料管理の上で比較的便利である。当然LEDエピタキシャル層34の上の第1電極36は発光輝度を高めるため、透明な材料で製造して透明電極とされりる。また、導電層326或いはGaN薄膜層324自体は導電材料で製造されるため、第2電極38を設けないで導電層326或いはGaN薄膜層324を以て代替

#### [0020]

することが可能である。

【発明の効果】総合すると、本発明の提供する直立式し EDとその電流流動回路の構造は、サファイアを基板と する青色光LEDにあって、サファイア基板中に第1電 極を中心として対称方式で、エッチングにより少なくと も一つのチャネルを設け、並びにとの中空のチャネル内 20 に導電材料を存在させ、これによりLEDの電流流動回 路を自然に形成して直立式青色光LEDを形成してお り、有効に電流流動の電流流動回路を画定し、その有効 領域の電流密度と発光効率を増加する。ゆえに本発明は 新規性、進歩性及び産業上の利用価値を有している。な お、上述の実施例は本発明の望ましい実施例に関する説 明であり、本発明の請求範囲を限定するものではなく、 本発明に基づきなしうる細部の修飾或いは改変はいずれ も本発明の請求範囲に属するものとする。例えば、LE Dエピタキシャル層とGa N薄膜層の間に、不純物層、 例えばAlGaInPを添加するか、或いはその他の薄 膜層の上にその他の、例えばSiC、AIN、SiO 』、InGaN、SnO』、AlInGaP層を増加し た形態が可能である。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】周知の直立式LEDの構造断面図である。

【図2】周知の電流阻止層を具えた直立式LEDの構造\*

\* 断面図である。

【図3】周知のサファイア基板の青色光LEDの構造断面図である。

【図4】本発明のサファイア基板のLEDの製造ステップの構造断面図である。

【図5】本発明のサファイア基板のLEDの製造ステップの構造断面図である。

【図6】本発明のサファイア基板のLEDの製造ステップの構造断面図である。

) 【図7】本発明のサファイア基板のLEDの製造ステップの構造断面図である。

【図8】本発明のサファイア基板のLEDの製造ステップの構造断面図である。

【図9】図4の単一チップの平面図である。

【図10】図5の単一チップの平面図である。

【図11】図8の単一チップの平面図である。

【図12】本発明の直立式LEDの単一チップの立体構造表示図である。

【図13】本発明のもう一つの実施例の構造断面図であ

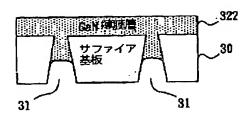
### 【符号の説明】

10 炭化シリコン基板	12 バッファ薄
膜層	
14 LEDエピタキシャル層	16 第1電極
18 第2電極	100 電流流動
回路	
20 サファイア基板	22 GaN薄
膜層	,
24 LEDエピタキシャル層	26 第1電極
30 サファイア基板	31 チャネル
322 GaN薄膜層	324 GaN薄
膜層	
326 導電層	34 LEDIE
タキシャル層	
36 第1電極	38 第2電極
300 電流流動回路	145 電流阻止
層	

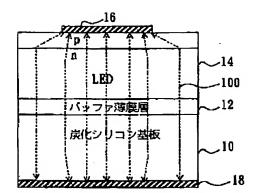
【図4】



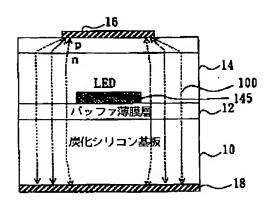
【図5】



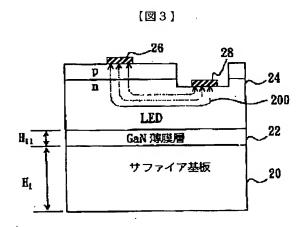
【図1】



【図2】

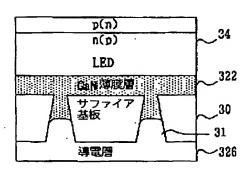


【図6】

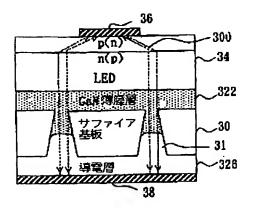




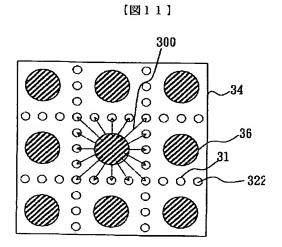
【図7】

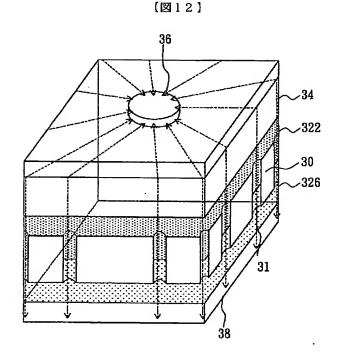


【図8】



【図9】 【図10】 О О \_30 \_322 О О 





【図13】

